

Presseinformation

Kyocera präsentiert seine Produkte auf der SMTconnect

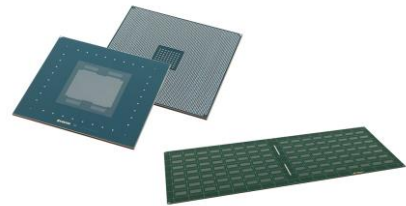
Kyocera stellt seine organischen Packaging-Lösungen sowie seine keramische Packaging-Technologie vom 11. bis 13. Juni 2024 auf der Fachmesse SMTconnect in Nürnberg vor.

Kyoto/Esslingen, 6. Juni 2024. Kyocera nimmt als Aussteller an der SMTconnect teil, die vom 11. bis 13. Juni in Nürnberg stattfindet. Diese Fachmesse spielt eine Schlüsselrolle rund um das Thema Elektronikfertigung in Europa. Kyocera wird dort eine Vielzahl der Hochleistungs-Produkte und Innovationen aus seiner Semiconductor Components Division (SC) präsentieren und damit seine Aktivitäten in diesen wichtigen Schlüsselmärkten unterstreichen.

Den Fokus seines Messeauftritts 2024 legt das Unternehmen auf Packaging-Lösungen auf Basis organischer Substrate, die in den Kyocera-Technologien FCBGA und ETC-FCBGA eingesetzt werden, sowie auf seine keramischen Packaging-Lösungen für SMDs, LEDs, CMOS-Sensors und viele weitere Produkte. Diese Lösungen adressieren den Elektronikmarkt, Netzwerkausrüstung und die Automobilindustrie sowie Anwendungen in mobilen IT-Geräten, für optische Kommunikation sowie in Mobilitäts- und Umweltlösungen.

1. Organische Substrate für Packaging-Lösungen

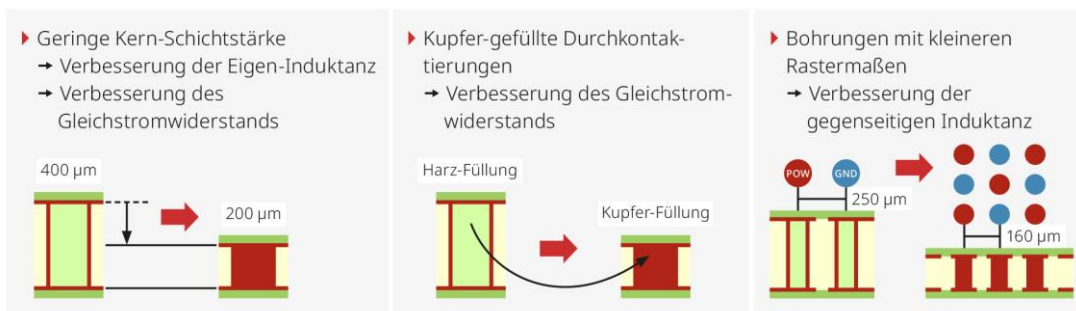
Kyocera bietet für Packaging-Lösungen Substrate aus organischen Materialien an, die den wachsenden Kundenanforderungen für eine Vielzahl von Anwendungen gerecht werden.



- **FCBCA-Technologie:** Die von dem Unternehmen angebotene FCBGA-Technologie (Flip-Chip Ball Grid Array) dient zum Packaging von Prozessoreinheiten wie zum Beispiel CPUs für Server, ASICs für Netzwerkkomponenten oder SoCs für den Automotive-Markt. Kyoceras hochentwickelte Technologie erlaubt große Gehäuseformate (bis zu etwa 120 Quadratmillimeter), eine hohe Layer-Anzahl (bis zu zehn), geringe Rastergrößen mit Leiterbreiten von 9 μm und Leiterabständen von 12 μm (8/8 später im Jahr 2024 geplant) sowie ideale Eigenschaften zur Impedanzkontrolle. Die eingesetzten Prozesse nutzen blei- und halogenfreie Ausgangsmaterialien.

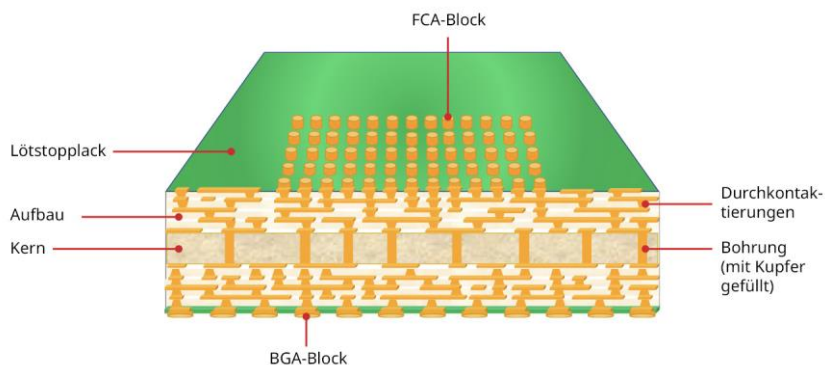
- ETC-FCBGA-Technologie:** Mit seiner Enhanced-Thin-Core- (ETC) FCBGA-Technologie schafft Kyocera die Voraussetzungen für eine noch bessere elektrische Performance. Möglich wird dies durch eine reduzierte Kern-Schichtstärke (bis hinunter zu 200 μm) sowie mit Kupfer statt Harz gefüllten Durchkontaktierungen, wodurch sich der Gleichstromwiderstand verbessern lässt. Die MSAP-Technologie (Modified Semi Additive Process) erlaubt feinere Strukturen im Kern-Layer. Darüber hinaus ermöglichen Laserschneidverfahren und hochentwickelte Design-Richtlinien kleinere Bohrungen mit Rastermaßen von bis zu 160 μm . Dies verbessert die sogenannte Induktanz und ermöglicht somit eine höhere Integration von Chipkomponenten. Gleichzeitig trägt eine verringerte Layer-Anzahl (bis zu sechs) dazu bei, Produktionskosten zu senken und Produktionszeiten zu beschleunigen.

Elektrische Performance



Kyoceras ETC-FCBGA-Technologie ermöglicht noch bessere elektrische Performance.

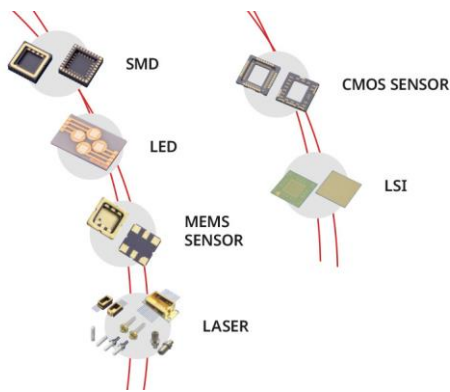
Schnittbild



Kyoceras ETC-FCBGA-Technologie erlaubt höhere Integration dank hochentwickelter Designrichtlinien und einer verringerten Layer-Anzahl.

2. Keramische Packaging-Technologie

Mit seiner keramischen Packaging-Technologie liefert Kyocera bewährte Lösungen, um integrierte Schaltungen vor Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit, Staub, Licht, elektromagnetischen Feldern und Wellen etc. sowie auch vor mechanischen Belastungen zu schützen. Darüber hinaus sorgt das aus mehreren Schichten aufgebaute Keramikgehäuse von ICs für die erforderliche Isolation der Eingangs- und Ausgangssignale und ermöglicht die Ableitung der im Betrieb erzeugten Wärme.



Keramisches Packaging kommt bei einer Vielzahl von Produkten zum Einsatz, wie beispielsweise SMDs, LEDs, CMOS-Sensoren, Komponenten für optische Kommunikation, Laser- und LiDAR-Einheiten und vielen anderen mehr. Die von Kyocera erreichten technologischen Fortschritte tragen zu einer digitalisierten Gesellschaft bei, erlauben kompaktere IoT- und Wearable-Geräte, höhere Netzwerkgeschwindigkeiten, größere Die-Formate bei Chips für hoch skalierbare Rechenzentren (HSDC, Highly scalable Data Centers) und KI-Cluster, höhere Laser-Ausgangsleistungen für industriellen Einsatz oder schnellere Datenübertragungen für Speicherzugriffe in anspruchsvollen Anwendungen wie generativer KI. Weitere Anwendungen von Kyoceras keramischer Packaging-Technologie umfassen die Einkapselung von kleinen, wiederaufladbaren Festkörperbatterien, Trägheitssensoren in Fahrzeugen sowie Gassensoren.

Mehrschichtige keramische Gehäuse mit elektrischen Signalkontakten ermöglichen es, integrierte Schaltungen hermetisch vor Umwelteinflüssen und mechanischen Belastungen zu schützen.

Mehrschichtige keramische Gehäuse mit elektrischen Signalkontakten ermöglichen es, integrierte Schaltungen hermetisch vor Umwelteinflüssen und mechanischen Belastungen zu schützen.

Überblick: Kyocera auf der SMTconnect

Veranstaltung	SMTconnect
Datum	11. bis 13. Juni 2024
Ort	Nürnberg
Kyocera-Stand	Halle 4, Stand 4-204

Über die Fachmesse SMTconnect

Die SMTconnect spielt beim Thema Elektronikfertigung eine Schlüsselrolle in Europa: Die Veranstaltung verbindet Menschen und Technologien aus den Bereichen Entwicklung, Fertigung, Service und Anwendung von mikroelektronischen Baugruppen und Systemen in einer



inspirierenden Atmosphäre. Unter dem Motto „Driving Manufacturing forward“ bietet die SMTconnect den idealen Rahmen, um Ideen innerhalb der Elektronikfertigungs-Community auszutauschen, maßgeschneiderte Lösungen für elektronische Baugruppen und Systeme zu entwickeln, Geschäftsabschlüsse anzubahnen und Kompetenzen zu steigern.

Für weitere Informationen zu Kyocera: www.kyocera.de

Über Kyocera

Bereits seit über 50 Jahren ist Kyocera in Europa erfolgreich. Von seinem europäischen Hauptsitz in Esslingen am Neckar betreibt die KYOCERA Europe GmbH 26 Standorte inkl. Produktionsstätten, wobei die Produktpalette von Feinkeramik-, Elektronik-, Automobil-, Halbleiter- und optischen Komponenten bis hin zu Industriewerkzeugen, LCDs, Touch-Lösungen, industriellen Druck-Komponenten, Solarsystemen und Konsumgütern wie Küchen- und Büroartikeln reicht.

KYOCERA Europe GmbH ist ein Unternehmen der KYOCERA Corporation mit Hauptsitz in Kyoto/Japan, einem weltweit führenden Anbieter von Halbleiter-, Industrie- und Automobil- sowie elektronischen Komponenten, Druck- und Multifunktionssystemen sowie Kommunikationstechnologie. Der Technologiekonzern ist weltweit einer der erfahrensten Produzenten von smarten Energiesystemen, mit mehr als 45 Jahren Branchenfachwissen. Die Kyocera-Gruppe umfasst 292 Tochtergesellschaften (31. März 2024). Mit etwa 79.200 Mitarbeitern erwirtschaftete Kyocera im Geschäftsjahr 2023/2024 einen Netto-Jahresumsatz von rund 12,29 Milliarden Euro.

Auf der „Global 2000“-Liste des Forbes-Magazins für das Jahr 2023 belegt Kyocera Platz 672 und zählt laut Wall Street Journal zu den „The World's 100 Most Sustainably Managed Companies“. Im zweiten aufeinanderfolgenden Jahr wurde Kyocera für den Nachhaltigkeitsindex (Asia-Pacific) von Dow Jones qualifiziert. Ebenfalls zum zweiten Mal in Folge hat Kyocera eine Goldbewertung in der EcoVadis-Nachhaltigkeitsumfrage erhalten und wurde bereits zum achten Mal von Clarivate als „Top 100 Global InnovatorTM 2023“ als einer der weltweiten Innovationsträger anerkannt.

Das Unternehmen engagiert sich auch kulturell: Über die vom Firmengründer ins Leben gerufene und nach ihm benannte Inamori-Stiftung wird der imageträchtige Kyoto-Preis als eine der weltweit höchstdotierten Auszeichnungen für das Lebenswerk hochrangiger Wissenschaftler und Künstler verliehen (umgerechnet ca. 596.500 Euro pro Preiskategorie).

Medienkontakt

KYOCERA Europe GmbH
Andrea Berlin
Fritz-Müller-Straße 27
73730 Esslingen / Deutschland
Tel: 0711/93 93 48 96
Mobil: +49 151 16 33 07 93
E-Mail: PR@kyocera.de
www.kyocera.de

Serviceplan Public Relations & Content
Hannah Lösch
Haus der Kommunikation
Friedenstraße 24
81671 München
Tel.: 089/2050 – 4116
E-Mail: h.loesch@house-of-communication.com